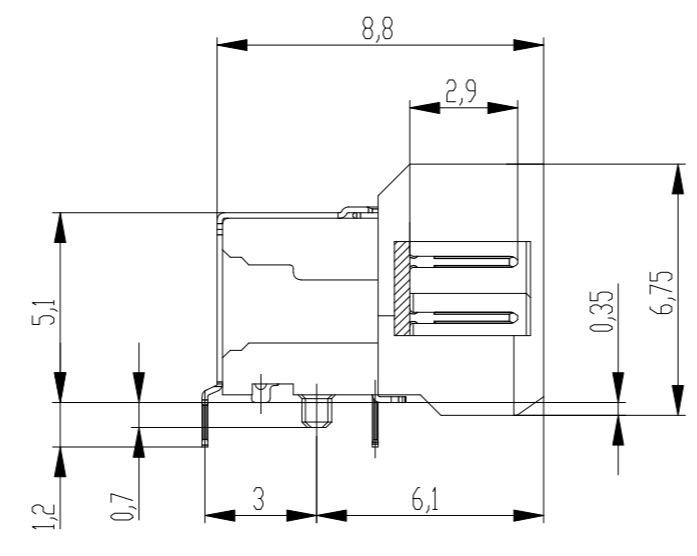
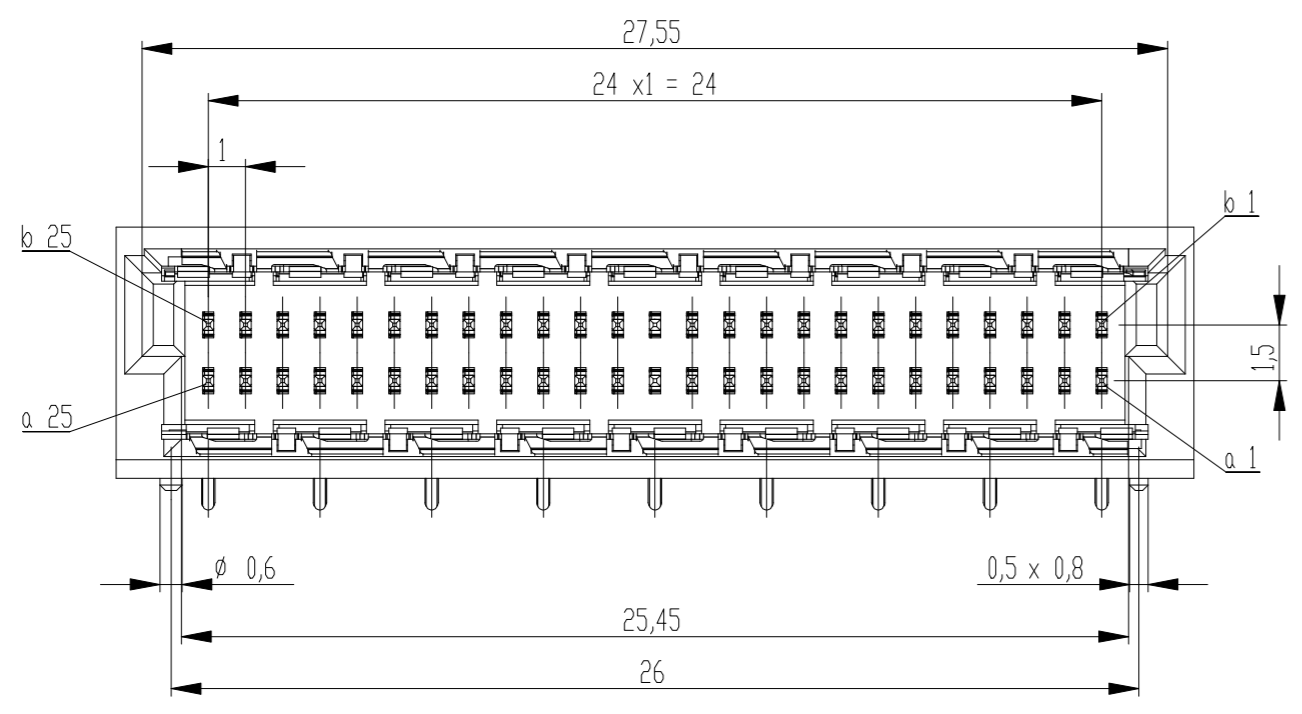
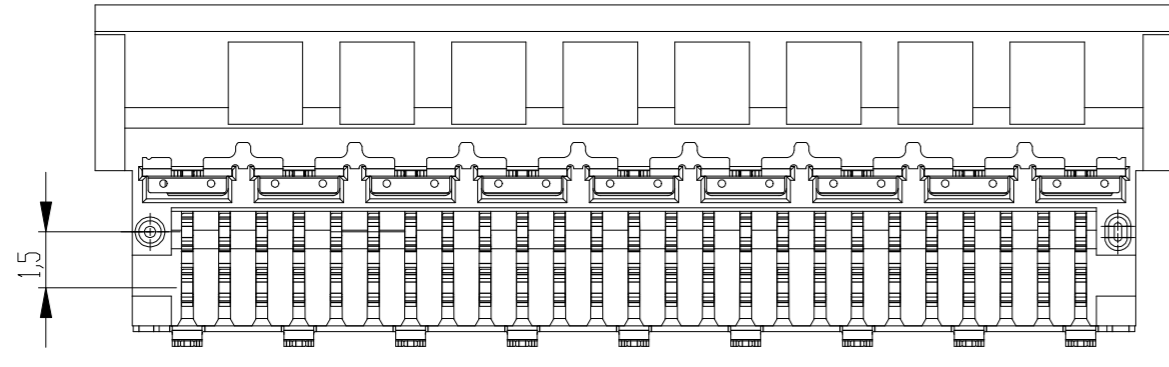
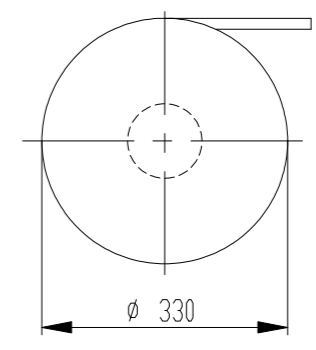
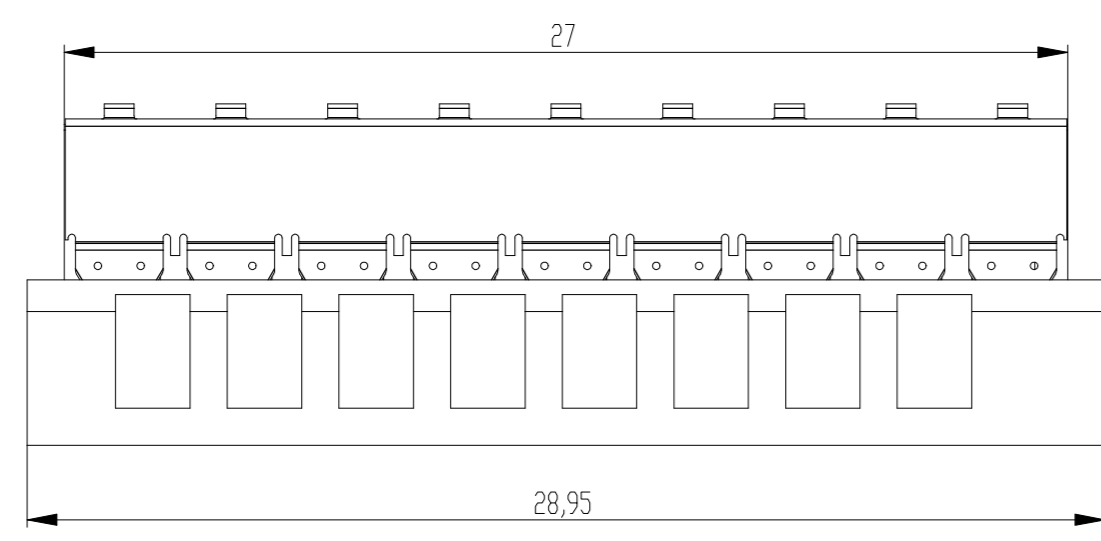
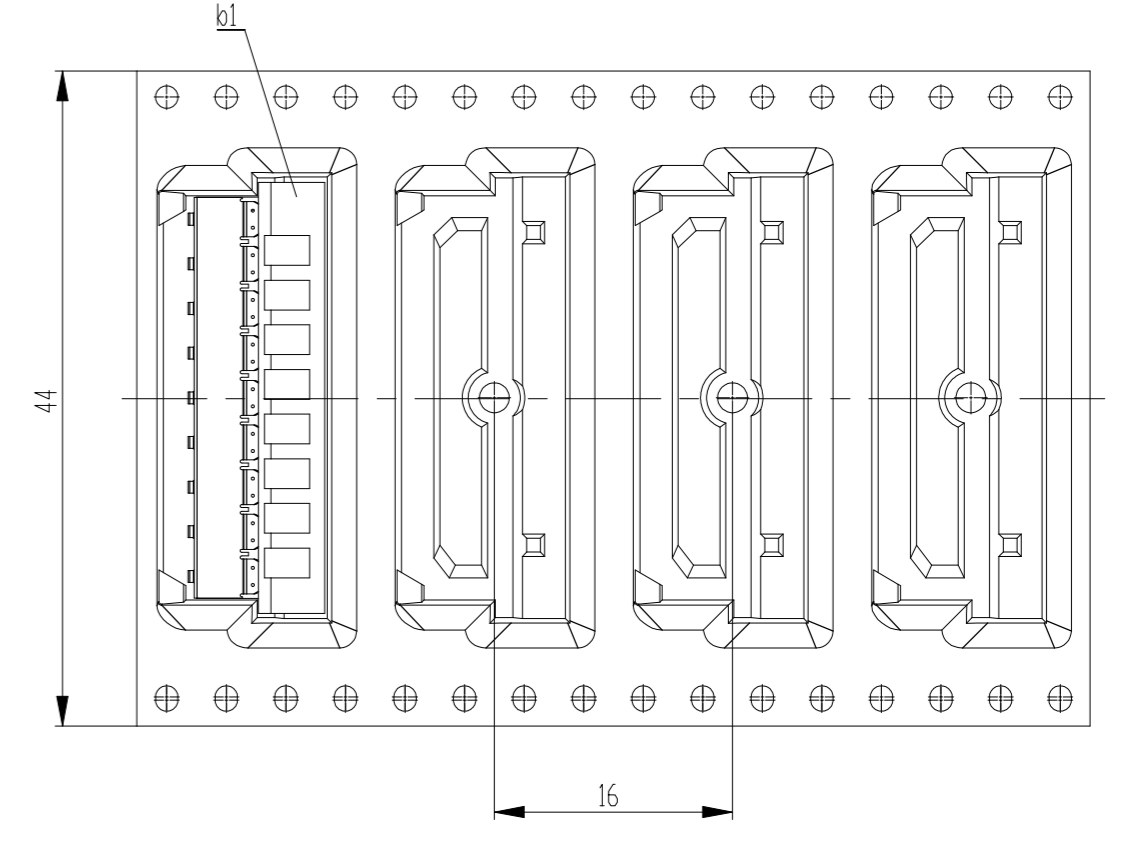


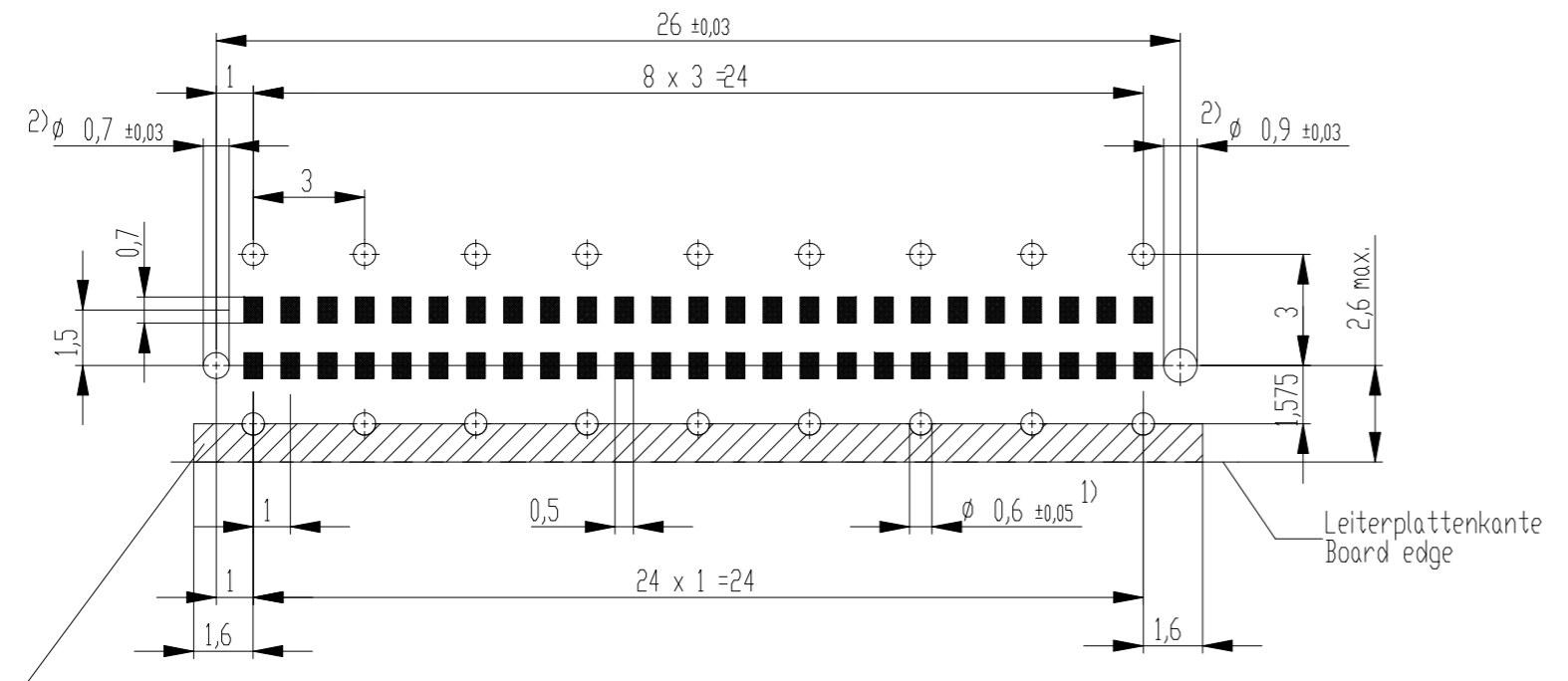
Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
 tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 400 Stück
 packaging unit: 400 pcs



Abspulrichtung - reel off direction



Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal



- 1) Fertigllochdurchmesser / Finished via diameter
- 2) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Anforderungsstufe 1
 performance level 1
 Kontaktbereich vergoldet
 mating area gold plating
 Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
 terminal area 4-6 µm tin plating
 Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
 coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der STMicroelectronics AG. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum der STMicroelectronics AG. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der STMicroelectronics AG. In case of any deviation the English version shall prevail.

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	Scale 5:1 Material
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	ERNI-Messlerl. 90° SMDTHR 50p BM EMV Male 90° SMDTHR 50co. BM EMV
g Index	26.05.2015 Date	TE Connectivity ©= 374722-E Class MSPEED
		1 A2